

**ТВЕРДОТЕЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОНИКА**

задание на типовой расчет (2008г)

В соответствии с вариантом задания (см. табл) для полупроводникового диода со структурой “ $p^+n$ ” рассчитать и построить графики следующих характеристик:

- 1) ВАХ при  $T=300K, 250 K, 370K$  (в линейном и логарифмическом масштабах).
- 2) Распределение инжектированных носителей заряда в  $p$  и  $n$  областях при  $U=0,5U_{\text{конт}}$  и при  $U=-100U_{\text{конт}}$
- 3) Зависимость контактной разности потенциалов от температуры ( $250K < T < 450K$ ).
- 4) Зависимость контактной разности потенциалов от степени легирования  $n$ -области
- 5) Зависимость обратного тока от температуры ( $250K < T < 450K$ ).
- 6) Зависимость обратного тока от степени легирования донорной примесью ( $T=300K, 10^{15} < N < 10^{18} \text{ см}^{-3}$ ).
- 7) Зависимость барьерной емкости диода от обратного напряжения ( $T=300K, -U_{\text{пробоя}} < U < 0$ ).
- 8) Зависимость диффузионной емкости от прямого тока ( $T=300K, J < 100 \text{ A/cm}^2$ ).
- 9) Предложить конструкцию диода.

№	Материал	$S, \text{мм}^2$	Толщина $p$ области, $\mu\text{мм}$	$N_{\text{акц}}(B) \text{ см}^{-3}$	Толщина $n$ области	$N_{\text{донор}}(\text{As}) \text{ см}^{-3}$	$\tau_p, \text{мкsec}$	$\tau_n, \text{мкsec}$
1	Si	10	0.8	$10^{17}$	130	$3 \cdot 10^{15}$	60	0.3
2	Si	20	1.0	$2 \cdot 10^{17}$	140	$4 \cdot 10^{15}$	50	0.4
3	Si	40	0.5	$4 \cdot 10^{17}$	150	$5 \cdot 10^{15}$	40	0.5
4	Si	60	0.6	$6 \cdot 10^{17}$	200	$6 \cdot 10^{15}$	30	0.6
5	Si	80	0.7	$7 \cdot 10^{17}$	50	$7 \cdot 10^{15}$	20	0.1
6	Si	30	0.8	$3 \cdot 10^{17}$	60	$8 \cdot 10^{15}$	10	0.2
7	Si	0.1	1.0	$5 \cdot 10^{17}$	70	$2 \cdot 10^{14}$	5	0.3
8	Si	0.2	0.5	$10^{18}$	80	$8 \cdot 10^{15}$	2	0.4
9	Si	0.4	0.6	$10^{17}$	90	$7 \cdot 10^{15}$	1	0.5
10	Si	0.8	0.7	$2 \cdot 10^{17}$	100	$6 \cdot 10^{15}$	6	0.6
11	Si	1	0.8	$4 \cdot 10^{17}$	110	$5 \cdot 10^{15}$	8	0.1
12	Si	2	1.0	$6 \cdot 10^{17}$	120	$4 \cdot 10^{15}$	10	0.2
13	Si	4	0.5	$7 \cdot 10^{17}$	130	$3 \cdot 10^{15}$	20	0.3
14	Si	8	0.6	$3 \cdot 10^{17}$	140	$3 \cdot 10^{15}$	40	0.4
15	Si	10	0.7	$5 \cdot 10^{17}$	150	$4 \cdot 10^{15}$	60	0.5
16	Si	20	0.8	$10^{18}$	200	$5 \cdot 10^{15}$	50	0.6
17	Ge	30	1.0	$10^{16}$	50	$6 \cdot 10^{14}$	40	0.3
18	Ge	40	0.5	$2 \cdot 10^{17}$	250	$4 \cdot 10^{14}$	30	0.4
19	Ge	50	0.6	$4 \cdot 10^{16}$	150	$8 \cdot 10^{15}$	20	0.5
20	Ge	70	0.8	$7 \cdot 10^{16}$	200	$10^{15}$	50	0.1
21	Ge	80	1.0	$3 \cdot 10^{16}$	300	$7 \cdot 10^{15}$	200	0.2

Примечания:

- времена жизни  $\tau_p$  и  $\tau_n$  указаны для неосновных носителей заряда;
- недостающие для расчета параметры могут быть выбраны проектантом исходя из общих физических соображений (и здравого смысла);
- предельная плотность тока не должна превышать  $500 \text{ A/cm}^2$ ;
- Предельную мощность рассчитывать исходя из предельного тока при прямом смещении.

→ без защиты В-недел.